

证券代码:600076

证券简称:康欣新材

公告编号:2026-014

康欣新材料股份有限公司

关于收购无锡宇邦半导体科技有限公司部分股权并对其增资事项获得国资委批复的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、基本情况概述

康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开了第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于收购无锡宇邦半导体科技有限公司部分股权并对其增资方案调整的议案》，公司拟通过受让股权加增资的方式取得无锡宇邦半导体科技有限公司（以下简称“宇邦半导体”）55%股权，具体内容详见公司于2026年2月12日在上海证券交易所网站披露的《康欣新材料股份有限公司关于收购无锡宇邦半导体科技有限公司部分股权并对其增资方案调整的公告》（公告编号：2026-010）。

根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述收购事项无需提交公司股东会审议，但需履行国资相关审批程序。

二、最新进展情况

近日，公司收到控股股东无锡市建设发展投资有限公司转发的无锡市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于康欣新材资产重组及收购宇邦半导体的批复》（锡国资改〔2026〕5号），原则同意

公司收购宇邦半导体，通过股权受让和增资方式取得宇邦半导体 55% 的股权。

截至本公告披露日，公司已完成本次收购的国资审批核心程序，后续将严格按照批复要求、前期披露的交易方案及相关法律法规规定，有序推进股权受让、增资款支付、工商变更登记等各项后续事宜，确保收购事项落地实施。

三、风险提示

本次收购后续尚需办理宇邦半导体的股权过户、工商变更、章程备案等手续，相关流程存在一定办理周期，公司将持续关注本次收购的后续进展，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续进展公告，并注意投资风险。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日